

激光切割系统 CutMaker软件+MCS控制卡

产品名称	激光切割系统 CutMaker软件+MCS控制卡
公司名称	北京金橙子科技股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市丰台区丰台路口139号319室（注册地址）
联系电话	010-64426993 17800213780

产品详情

激光切割系统是金橙子自主研发的适用于光纤激光切割的控制系统，具有优异的运动控制算法及工艺处理功能，该系统操作简便、功能丰富、稳定可靠、性能强大，能够为客户提供完整的激光加工解决方案，可广泛用于广告制作、工程机械、汽车制造、3C电子、医疗器械等行业。

JT218独立调高器

系统优势自定义PLC

五级穿孔+动态变焦（闪电穿孔）

功率曲线

排版

超快玻璃切割PSO功能

一键切断

寻边

误差测定

自动化

1、智能蛙跳；2、视觉定位；3、自定义PLC；4、多文件加工；5、双交换工作台；6、气压校正；7、激光干涉仪。

系统工艺模块

1、引线工艺；2、快速穿孔工艺；3、高精度图层工艺。

软件

CutMaker软件

典型应用汽车零部件

汽车材料有低碳低合金钢、高强钢、耐大气腐蚀钢、铁素体不锈钢、奥氏体不

锈钢及铝合金等，激光切割设备均可以加工，其加工范围几乎可以涵盖汽车中所有材质的板材件。金橙子激光切割控制系统的S型加减速算法，在汽车零部件切割，使其定位精度更高，运行速度更快，提高了汽车零部件的加工精度、质量、效率。

3C电子

激光切割可对金属或非金属零部件等小型工件进行精密切割或微孔加工，具有切割精度高、速度快、热影响小等优点。金橙子激光切割系统的多工位、PLC功能，广泛应用在手机、笔记本电脑、照相机等电子产品的切割，其主要优势为：加工尺寸精准，轮廓清晰，特别是对于高硬度、高脆性及高熔点的各种高端材料精细加工，能有效的提高加工质量，并且无接触式切割相对传统刀具切割，提高了产品的良品率。

玻璃切割

以玻璃为代表的脆性材料切割是激光加工领域的新应用，配合超快激光器，以及金橙子激光切割系统的PSO功能（500mm/s速度下的弧线，点间距精度 $\pm 0.2\mu\text{m}$ ），能够对玻璃进行高速高精度切割，配合后期裂片工艺，得到高质量的玻璃外形产品。
